

Schablonenreiniger – ready-to-use

SYS-CLEAN[®] STC1.0 ist ein wasserbasierendes Reinigungsmedium zur Reinigung von SMT Druckschablonen bereits bei Raumtemperatur.

SYS-CLEAN[®] STC1.0 reinigt zuverlässig Lotpasten von Schablonen und Fehldrucken. Der Reiniger kann sowohl im Sprühverfahren, als auch in Tauch- oder Ultraschallanlagen eingesetzt werden.



Anwendungsbereich

Verschmutzung	Eignung
Lotpasten	✓ ✓
SMT-Kleber bzw. Leitkleber	✓
Flussmittel	✓
Öle/Fette	✓

Anwendungsparameter

Parameter	
Anwendungstemperatur	20°C
Reinigungsdauer ca.	4-6 min.
Spülung	STC1.0 / VE-Wasser
Trocknung	Konvektion / Druckluft
Einsatzkonzentration	ready-to-use

✓ ✓ = Exzellent ✓ = Optimal ○ = Optional ✗ = Nicht Empfohlen

Technische Daten

SYS-CLEAN[®] STC1.0 wird als Fertigmischung ausgeliefert.

pH-Wert	7,7
Dichte (bei 20°C)	0,9995 g/cm ³
Brechungsindex (bei 20°C)	1,3522
Siedebeginn und Siedebereich	>100 °C
Flammpunkt	n. A.

Anwendungsart	
Sprühreinigung	✓ ✓
Tauchreinigung – Perlator	✓ ✓
Tauchreinigung – Sprühsystem	✓ ✓
Ultraschallreinigung	✓ ✓
Manuell	✓

✓ ✓ = Exzellent ✓ = Optimal ○ = Optional ✗ = Nicht Empfohlen

Vorteile:

SYS-CLEAN® STC1.0 ist sehr gut filtrierbar und verfügt über ein optimiertes Ablaufverhalten wodurch sich der Verbrauch reduziert und ölige Rückstände vermieden werden. Durch die hohe Beladungskapazität ist ein besonders kostengünstiger Prozess gewährleistet.

Da sich das Medium nicht separiert, ist ein Einsatz in der Unterseitenreinigung problemlos realisierbar.

Verfügbarkeit:

SYS-CLEAN® STC1.0 Fertiggemisch ist in folgenden Größen erhältlich

Artikelnummer: 64904042 – 1L

Artikelnummer: 64903565 – 5L

Artikelnummer: 64903511 – 25L

Artikelnummer: 64903512 – 200L



Registration, Evaluation and
Authorisation of Chemicals

Das Produkt ist frei von
bedenklichen
Inhaltsstoffen gemäß der
SIN- & SVHC-Listen



100% konform mit den EU
Richtlinien RoHS 1 & 2,
WEEE